「COMNEXT -次世代 通信技術＆ソリューション展-」
パナソニック インダストリー出展のご案内

謹啓　秋晴の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2026年12月2日（水）から4日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにて「COMNEXT-次世代 通信技術＆ソリューション展-」が開催されます。

AIデータセンターや次世代通信インフラにはさらなる高速・大容量化とともに省電力化や安定した電力運用が求められています。パナソニック インダストリーは、これらのお客様の課題解決に貢献する製品・ソリューションとして「電気二重層キャパシタ」「基板対FPCコネクタ」「PhotoMOSリレー」の展示を予定しております。ぜひ会場にお越しいただき、ご覧くださいますようお願い申し上げます。

謹白



会　期

2026年12月2日（水）～12月4日（金）　10:00～17:00
（別紙ご招待状：500円分ランチ引き換え券は、会場インフォメーションカウンターにご提示ください）

会　場

東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）　：　西ホール　C3-60

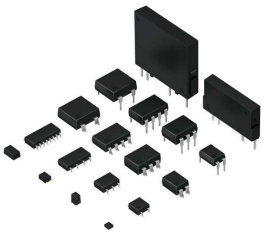
来場登録

「無料事前登録」はこちら　https://www.cbw-expo.jp/ja-jp/register.html?code=1808734545238614-DPQ

展　示　品


「電気二重層キャパシタ」


「基板対FPCコネクタ」


「PhotoMOSリレー」

「展示詳細」はこちら　https://ac-blog.panasonic.com/comnext-pid

併設展示のご紹介（弊社ブース対面）

パナソニックFSエンジニアリング株式会社
超高精度三次元測定機UA3Pを展示しております。



発行元

パナソニック インダストリー株式会社　メカトロニクス事業部